

103學年度科技部計畫案

1	電子系	科技部	使用影像處理之縫紉機影像與圖像繡花技術研究	103/08/01-104/07/31	NSC 101-2221-E-167-034-MY2	陳文淵	612,000
2	電子系	科技部	具溫度保護與內嵌語音辨識功能之LED燈晶片設計與系統級封裝整合	103/08/01-104/07/31	NSC 101-2221-E-167-020-MY2	洪玉城	521,000
3	電子系	科技部	基於改良式有限元素法與模態展開法之多類型高效能局部表面電漿光纖感測器之研究	103/08/01-104/07/31	NSC 102-2221-E-167-014	何岳璟	658,000
4	電子系	科技部	3D 軟性基板1T2R 結構記憶體元件之開發	103/08/01-104/07/31	NSC 102-2221-E-167-011	游信強	680,000
5	電子系	科技部	電子系研究生楊智凱擬於103年8月4日至103年8月6日赴日本札幌(Sapporo)參加應用與創新學生大賽	103/08/04-103/08/06	MOST-103-2922-I-167-003	曾振東	26,000
6	電子系	科技部	鎳鎘/鎳氫電池品質檢測結合資料庫管理系統	104/02/01-105/01/31	NSC 104-2622-E-167-002-CC2	林熊徵	1,003,360
7	電子系	科技部	電子系碩士班研究生吳思蓉於104年5月26日至29日參加2015年亞太電磁相容研討會	104/05/26-104/05/29	MOST-104-2922-I-167-002)	曾振東	9,000

		合計					3,509,360
--	--	----	--	--	--	--	-----------